

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-032

上海盟科药业股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东减持的基本情况:截至本公告披露日,上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”或股东 Best Idea International Limited(以下简称“Best Idea”)持有公司股份45,320,667股,占公司股份总数的6.91%;股东 JSR Limited(以下简称“JSR”)持有公司股份28,591,294股,占公司股份总数的4.36%;股东 GP TMT Holdings Limited(以下简称“GP TMT”)持有公司股份17,289,247股,占公司股份总数的2.64%。JSR与GP TMT为一致行动人,二者合计持有公司股份45,880,541股,占公司股份总数6.99%。上述股份均为公司首次公开发行并上市前取得的股份。
- 减持计划的主要内容:公司于近日收到 Best Idea、JSR 及 GP TMT 出具的《关于股东减持计划的告知函》,股东 Best Idea 计划根据市场情况拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 19,686,860 股,即不超过公司总股本的3%;股东 JSR 及 GP TMT 作为一致行动人,计划根据市场情况拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 19,686,860 股,即不超过公司总股本的3%。
- 本次减持主要是股东自身资金需求,减持价格将根据市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、送红股、转增股本、配股等权益事项,则上述减持计划作相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	Best Idea
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 <input type="checkbox"/> 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:不适用
持股数量	45,320,667 股
持股比例	6.91%
当前持股股份来源	IPO前取得:45,320,667 股
股东名称	JSR
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 <input type="checkbox"/> 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:与另一一致行动人合计持有股份超过5%
持股数量	28,591,294 股
持股比例	4.36%
当前持股股份来源	IPO前取得:28,591,294 股
股东名称	GP TMT
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 <input type="checkbox"/> 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:与另一一致行动人合计持有股份超过5%
持股数量	17,289,247 股
持股比例	2.64%
当前持股股份来源	IPO前取得:17,289,247 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	JSR	28,591,294	4.36%	金融地产投资基金管理有限公司为 JSR 和 GP TMT 管理的第一大股东(持股 30%)
	GP TMT	17,289,247	2.64%	
	合计	6,880,541	6.99%	

注:表格中数据如有尾差,为四舍五入所致。

大股东过去 12 个月内减持股份情况:
 公司股东 Best Idea、JSR 于 2025 年 4 月 4 日通过询价转让方式分别减持其所持有的 10,313,714 股、7,735,206 股股份,占公司股份总比例分别为 15.7%、11.8%,转让价格为 657 元/股,详见公司分别于 2025 年 8 月 22 日、8 月 23 日、9 月 5 日披露的《上海盟科药业股份有限公司股东减持计划公告》(公告编号:2025-033)、《上海盟科药业股份有限公司股东减持计划公告》(公告编号:2025-034)、《上海盟科药业股份有限公司股东减持计划公告》(公告编号:2025-038)及《上海盟科药业股份有限公司关于股东减持计划期间届满减持股份实施结果且权益变动触及 1%的公告》(公告编号:2026-006)。
 公司股东 Best Idea、JSR 及 GP TMT 于 2025 年 10 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日通过集中竞价方式减持其所持有的 6,566,064 股、2,253,190 股、1,072,070 股股份,占公司股份总比例分别为 10.06%、0.34%、0.16%,详见公司分别于 2025 年 9 月 10 日及 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《上海盟科药业股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-038)及《上海盟科药业股份有限公司关于股东减持计划期间届满减持股份实施结果且权益变动触及 1%的公告》(公告编号:2026-006)。
 公司股东 Best Idea 于 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 4 月 30 日通过集中竞价方式减持其所持有的 6,562,283 股股份,占公司股份总比例 100%。(以减持结果公告日公司总股本计算比例),详见公司于 2026 年 1 月 15 日及 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站披露《上海盟科药业股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-012)、《上海盟科药业股份有限公司关于股东减持计划期间届满减持股份实施结果且权益变动触及 1%的公告》(公告编号:2026-029)。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
Best Idea	10,313,714	15.7%	2025/04-2025/04	657-657	2025年9月22日
	6,566,064	10.06%	2025/10/9-2026/1/8	610-718	2025年9月10日
	6,562,283	10.06%	2026/05-2026/04/30	546-641	2026年1月15日
	7,735,206	11.8%	2025/04-2025/04	657-657	2025年9月22日
JSR	2,253,190	0.34%	2025/10/9-2026/1/8	655-625	2025年9月10日
GP TMT	1,072,070	0.16%	2025/10/9-2026/1/8	912-825	2025年9月10日

注:表格中比例系以减持结果公告日公司总股本计算,数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、减持计划的主要内容

股东名称	Best Idea
计划减持数量	不超过:19,686,860 股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:6,562,283 股 大宗交易减持,不超过:13,124,577 股
减持期间	2026年6月9日-2026年9月6日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	资金需求
股东名称	JSR
计划减持数量	不超过:13,126,872 股
计划减持比例	不超过:2.05%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:4,445,280 股 大宗交易减持,不超过:8,681,592 股
减持期间	2026年6月9日-2026年9月6日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	资金需求
股东名称	GP TMT
计划减持数量	不超过:6,250,978 股
计划减持比例	不超过:0.97%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:2,116,988 股 大宗交易减持,不超过:4,133,990 股
减持期间	2026年6月9日-2026年9月6日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	资金需求

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

- (一) 相关披露是否存在其他安排 是 否
- (二) 大股东及董监高此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,Best Idea、JSR 及 GP TMT 对其所持有的股份承诺如下:

- “自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让其本人直接间接所持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份,也不授权该发行人回购该部分股份;
 - 本人承诺人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已出具的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份;
 - 限售期满后两年内,若本人根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,同时结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格应符合相关法律法规及上海证券交易所规则的要求;
 - 本人承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定。”
- 本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否
- (三) 是否否属于上市未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否
- (四) 本次减持的其他事项
无。
- 三、控股股东或实际控制人减持首发前股份
是否系控股股东或者实际控制人减持首发前股份的情况 是 否
- 四、减持计划相关风险提示
 (一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情形等本次减持计划是公司股东 Best Idea、JSR 及 GP TMT 根据自身资金需求进行的减持,减持价格将根据市场价格确定,不会对公司的治理结构及持续经营情况产生重大影响,在减持期间内,股东将根据市场行情、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量 and 价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
 (二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否
 (三) 其他风险提示
 本次减持股票计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在股东执行上述计划减持公司股票期间,公司将严格遵守有关法律法规,及时履行后续信息披露义务。
 特此公告。
 上海盟科药业股份有限公司董事会
 2026 年 5 月 19 日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临 2026-014

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 18 日上午 11:00-12:00 通过在线在路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的形式召开了 2026 年第一季度业绩说明会,针对公司 2026 年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流,现将有关事项公告如下:
 一、本次说明会召开情况
 2026 年 5 月 9 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开 2026 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2026-012),并向广大投资者征集大家关心的问题。
 公司于 2026 年 5 月 18 日上午 11:00-12:00,通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的形式召开了 2026 年第一季度业绩说明会,公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段国良先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会,针对公司 2026 年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
 问题 1:晶方科技“一费两赢”(特指是汇率和管理层)的压力如何缓解?
 答:汇率波动和地缘政治风险是汇率波动所致,公司将通过平衡外币资产和负债结构,降低相关影响,子公司管理费用的增加,主要系积极应对国际贸易形式,积极获取客户订单,有效提升业务规模所致,相关费用的产生是阶段性的。
 马来西亚生产基地已完成土地厂房购买相关的协议签署、资产交割、工厂务系统、无尘室装修的施工接近尾声,并开始在生产工艺与设备选型采购,团队组建与培训阶段,预计年底开始打样、试生产, 感谢您的关注!
 问题 2:公司积极推进光电封装、光电互联等技术,以应对 AI 芯片、自动驾驶对先进封装的需求,本年度预计会产生多少营收?是否有合同落地,还是单纯地光电封装?
 答:您好,公司专注于集成电路先进封装技术,拥有晶圆级封装技术和晶圆级光学加工能力等技术优势,随着 AI 技术的快速发展,AI 芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用领域正不断对先进封装技术创新提出需求,尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案,如堆叠、光电互联等,公司作为晶圆级 TSV 封装技术的领先者,将继续密切关注产业动态与市场需求,积极加强技术储备,推进技术创新与市场应用拓展,不能确定具体的商业化落地进度,不存您所述的风险, 感谢您的关注!

问题 3:目前马来西亚工厂的无尘室建设和设备采购进展如何?预计今年具体哪个月份能正式启动投产并开始做营收?该地近期的产能规划主要面向哪些核心客户或市场领域?公司目前在海外拥有可观的巨额现金储备,除了日常运营马来西亚西贡“外,管理层面在“外延式扩张”方面是否有明确的规划?未来是否还会考虑通过并购来快速扩大营收规模,或者通过加大分红、回购等方式来回报中小股东? 随着 AI 芯片对先进封装需求的爆发,公司在 CPO(光共封装)、光电互联等前沿技术上,目前是否已经有具体的产品落地进入了头部客户的供应链体系?
 答:马来西亚生产基地正在无尘室装修验收与设备采购阶段,生产工厂务、团队组建与培训等工作正在同步开展,预计在年底投入样件生产阶段,公司马来西亚西贡生产基地目前旨在提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,客户信息为公司商业信息,公司有保密义务。
 公司资产雄厚,盈利与现金流能力良好,公司充足的现金储备由良好的盈利能力积累而来,也是公司未来持续发展的坚实基础,公司将一如既往的顺应市场与产业发展需求,加大技术工艺自主研发投入和先进技术的并购拓展,积极强化国际化的研发、业务、生产制造能力布局,进一步提升全球范围内的产业地位。
 公司在光共封装等新兴领域的拓展布局情况详见前述回复, 感谢您的关注!
 问题 4:您好,请问公司最近有签订订单或准备签订订单?
 答:晶方科技与客户保持稳定、具体合作金额及商务条款不能披露,公司将依规披露重大业务合作事项,请予以关注, 感谢您的关注!

问题 5: AI 光互联与 1.6T 光模块领域:1.目前公司在 1.6T 光模块相关的硅光衬底 TSV 封装技术上的良率表现如何?随着硅光衬底 CPO/OIO 路线演进,公司与硅光厂商(商在 2.5D/3D 先进封装领域的联合研发项目,预计在 2026 年下半年能实现多少营收占比? 2.在 AI 算力需求持续旺盛的驱动下,公司针对光电异构集成(Caplet)的技术储备是否已经实现从“技术研发”到“量产应用”的跨越?目前在手订单中,来自数据中心高速通信类业务的订单增长情况如何? 3.汽车电子领域:随着 Robotaxi 及商用自动驾驶系统需求的大幅下降,公司 12 英寸车载 CIS 封装产线的能力利用率是否已接近饱和?苏州新扩建的产线在上半年的投产进度是否符合预期? 2.在激光雷达封装领域,公司与头部 Tier 1 厂商合作的晶圆级微透镜阵列项目目前是否已进入大规模量产阶段?针对全激光雷达的先进封装技术,公司目前的市场占有率是多少? 3.公司在车载 CIS 功率器件上的进展如何?2026 年是否可实现与主流车企或 Tier 1 供应商量产车型上的定点或大批量?
 答:您好,关于公司在光共封装等新兴领域的拓展布局情况详见前述回复。
 随着汽车智能化的快速发展,车载 CIS、激光雷达、智能投影等产品应用需求不断增长,公司为全球车载 CIS 晶圆级 TSV 封装技术的领先者,行业优势地位显著,车载 CIS 封装业务规模呈现快速增长趋势,车载晶圆级微透镜阵列业务、激光雷达封装业务已实现量产,公司目前产能利用状态良好,并将通过生产能力的有效提升,满足客户与市场需求。

证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2026-016

杭华油墨股份有限公司关于召开 2026 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 会议召开时间:2026 年 5 月 26 日(星期二)上午 9:30-11:30
 ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)
 ● 会议召开方式:上证路演中心、网络视频会议结合
 ● 投资者可于 2026 年 5 月 19 日(星期二)至 5 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stock@hink.com 进行提问,说明会上公司将信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
 杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)已分别于 2026 年 4 月 26 日、2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《杭华油墨股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭华油墨股份有限公司 2026 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年度和 2026 年第一季度经营成果、经营现状,公司于 2026 年 5 月 26 日(星期二)9:30-11:30 举行 2026 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
 一、说明会类型
 本次业绩说明会以视频会议网络互动召开,公司将针对 2026 年度和 2026 年第一季度的经营现状与财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间、地点
 本次业绩说明会将于 2026 年 5 月 26 日(星期二)上午 9:30-11:30 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频会议网络互动形式召开。

证券代码:688765 证券简称:禾元生物 公告编号:2026-017

武汉禾元生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 截至本公告披露日,武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海同盛永企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海同盛”)持有公司股份 20,084,400 股,占公司总股本的 5.62%。
 ● 上海同盛本次质押股份为 6,340,000 股,占其持股总数的 31.57%,占公司总股本的 1.77%。本次质押完成后,其累计质押股份 18,070,000 股,占其持股总数的 89.97%,占公司总股本的 5.05%。
 公司于近日收到公司股东上海同盛的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:
 一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东及实际控制人	本次质押股数	是否分期质押	是否补充质押	质押起始日	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司股本比例	质押用途
上海同盛	否	6,340,000	是	否	2026年5月19日	申请借款质押之日止	江苏银行股份有限公司	31.57%	1.77%	为第三方提供担保

证券代码:603051 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-053

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于“韦尔转债”回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 回售时间:2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 14 日
 ● 回售有效申报数量:10 张
 ● 回售金额:1,007.20 元(含当期利息、含税)
 ● 回售资金发放日:2026 年 5 月 19 日
 ● 本次可转债回售的公告情况
 豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于“韦尔转债”回售的公告》,并分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 1 日、2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日、2026 年 5 月 9 日、2026 年 5 月 12 日、2026 年 5 月 13 日、2026 年 5 月 14 日披露了关于“韦尔转债”回售的提示性公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 公司于近日收到回售转债代码为“171616”,回售价格为 100.72 元/张(含当期利息),回售申报期为 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 14 日,回售申报截止于 2026 年 5 月 14 日上海证券交易所收市后结束。

公司投资的以色列 Visic 公司为全球领先的第三代半导体 GaN(氮化镓)器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的 400V/650V/800V 等逆变器方案,其 DOGAN 技术具有导通电阻低,开关频率高,损耗小,可靠性高等特点,目前 Visic 公司将车用逆变器领域作为主要拓展领域之一,正积极和知名汽车厂家或 Tier1 厂商进行芯片及模块设计合作。

问题 6:请问公司在玻璃基板/ITGV、CPO 互互联封装等前先进封装领域,目前的技术进展、客户拓展情况如何?未来是否有产能扩张或市场拓展提升的具体目标?
 答:公司专注于传感器领域晶圆级 TSV 先进封装技术服务,关于在光电互联等新兴领域的拓展布局情况请见前述回复, 感谢您的关注!

问题 7:安特韦光光电官网产品介绍中的光学透镜阵列可用于光阵列,请问相关产品在光通信领域产品竞争力怎么样?是否已有订单产生?
 答:您好,该项目为公司牵头承担的国家级重点研发计划项目,项目针对高端 MEMS 传感器先进封装测试需求,建立基于标准的面向图像传感器、硅基麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台,目前项目技术工艺开发、客户拓展、商业化应用等均有有效推进,项目正处于验收阶段。该项目的有效实施将进一步推进公司在先进封装技术领域的技术领先优势与制造服务能力,有力提升公司在高端 MEMS 领域的市场拓展与业务规模。

问题 10:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 11:你好,主要想了解关于公司以下几个问题:1.目前公司订单量如何,业务量是否有受到手机消费电子市场下滑的影响?2.海外参股公司 VISIC 目前合作进展如何?是否考虑设立全资子公司进一步推进生产国产化?3.未来马来西亚工厂是否是主要承接海外新客户订单,还是将自给国产订单转移至海外生产?
 答:公司前生产运营有序开展,业务拓展稳步推进,订单与业务情况保持良好,虽然手机消费电子市场景气度承压,但受益于汽车电子的快速发展,对 CIS 等智能传感器的市场需求将有所增加,公司作为全球领先传感器领域先进封装技术领域的领先者,将通过技术的持续创新,生产能力的有效布局,积极拓展市场机遇。

公司投资的以色列 Visic 公司为全球领先的第三代半导体 GaN(氮化镓)器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的 400V/650V/800V 等逆变器方案,其 DOGAN 技术具有导通电阻低,开关频率高,损耗小,可靠性高等特点,目前 Visic 公司将车用逆变器领域作为主要拓展领域之一,正积极和知名汽车厂家、Tier1 等厂商进行芯片及模块的设计、开发与生产。
 公司马来西亚西贡生产基地的布局,是为了有效应对国际贸易竞争与地缘政治博弈风险,在全球产业链重构整合新形势下,顺应客户要求,承接国际海外客户订单,从而保持公司在全球产业新分工中的产业地位, 感谢您的关注!

问题 12:请问公司目前在 3D 封装集成、晶圆级封装、TSV 工艺等高端先进封装技术上的整体进展如何?十二英寸产线对应的技术难点、良率提升与产能释放节奏?面向高算力与光电计算领域,公司后续技术迭代方向,核心技术壁垒以及全规模化量产与业务落地规划能需要哪些?
 答:您好,公司专注于集成电路先进封装技术,拥有全球领先的智能传感器先进封装技术开发与服务商,拥有 8 英寸、12 英寸晶圆级 TSV 封装产线,具备从晶圆级到芯片级综合封装服务能力,尤其在晶圆级 TSV 先进封装技术领域,公司拥有技术、生产、市场、客户等方面显著的领先优势。
 公司目前 12 英寸晶圆级 TSV 等产线的产能利用状态良好,并将通过技术工艺的创新迭代,持续提升生产能力与效率,满足客户与市场需求。

问题 13:随着 AI 算力需求持续旺盛的驱动下,公司针对光电异构集成(Caplet)的技术储备是否已经实现从“技术研发”到“量产应用”的跨越?目前在手订单中,来自数据中心高速通信类业务的订单增长情况如何? 3.汽车电子领域:随着 Robotaxi 及商用自动驾驶系统需求的大幅下降,公司 12 英寸车载 CIS 封装产线的能力利用率是否已接近饱和?苏州新扩建的产线在上半年的投产进度是否符合预期? 2.在激光雷达封装领域,公司与头部 Tier 1 厂商合作的晶圆级微透镜阵列项目目前是否已进入大规模量产阶段?针对全激光雷达的先进封装技术,公司目前的市场占有率是多少? 3.公司在车载 CIS 功率器件上的进展如何?2026 年是否可实现与主流车企或 Tier 1 供应商量产车型上的定点或大批量?
 答:您好,关于公司在光共封装等新兴领域的拓展布局情况详见前述回复。
 随着汽车智能化的快速发展,车载 CIS、激光雷达、智能投影等产品应用需求不断增长,公司为全球车载 CIS 晶圆级 TSV 封装技术的领先者,行业优势地位显著,车载 CIS 封装业务规模呈现快速增长趋势,车载晶圆级微透镜阵列业务、激光雷达封装业务已实现量产,公司目前产能利用状态良好,并将通过生产能力的有效提升,满足客户与市场需求。

问题 14:您好,请问公司最近有签订订单或准备签订订单?
 答:晶方科技与客户保持稳定、具体合作金额及商务条款不能披露,公司将依规披露重大业务合作事项,请予以关注, 感谢您的关注!

问题 15: AI 光互联与 1.6T 光模块领域:1.目前公司在 1.6T 光模块相关的硅光衬底 TSV 封装技术上的良率表现如何?随着硅光衬底 CPO/OIO 路线演进,公司与硅光厂商(商在 2.5D/3D 先进封装领域的联合研发项目,预计在 2026 年下半年能实现多少营收占比? 2.在 AI 算力需求持续旺盛的驱动下,公司针对光电异构集成(Caplet)的技术储备是否已经实现从“技术研发”到“量产应用”的跨越?目前在手订单中,来自数据中心高速通信类业务的订单增长情况如何? 3.汽车电子领域:随着 Robotaxi 及商用自动驾驶系统需求的大幅下降,公司 12 英寸车载 CIS 封装产线的能力利用率是否已接近饱和?苏州新扩建的产线在上半年的投产进度是否符合预期? 2.在激光雷达封装领域,公司与头部 Tier 1 厂商合作的晶圆级微透镜阵列项目目前是否已进入大规模量产阶段?针对全激光雷达的先进封装技术,公司目前的市场占有率是多少? 3.公司在车载 CIS 功率器件上的进展如何?2026 年是否可实现与主流车企或 Tier 1 供应商量产车型上的定点或大批量?
 答:您好,关于公司在光共封装等新兴领域的拓展布局情况详见前述回复。
 随着汽车智能化的快速发展,车载 CIS、激光雷达、智能投影等产品应用需求不断增长,公司为全球车载 CIS 晶圆级 TSV 封装技术的领先者,行业优势地位显著,车载 CIS 封装业务规模呈现快速增长趋势,车载晶圆级微透镜阵列业务、激光雷达封装业务已实现量产,公司目前产能利用状态良好,并将通过生产能力的有效提升,满足客户与市场需求。

问题 16:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 17:安特韦光光电官网产品介绍中的光学透镜阵列可用于光阵列,请问相关产品在光通信领域产品竞争力怎么样?是否已有订单产生?
 答:您好,该项目为公司牵头承担的国家级重点研发计划项目,项目针对高端 MEMS 传感器先进封装测试需求,建立基于标准的面向图像传感器、硅基麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台,目前项目技术工艺开发、客户拓展、商业化应用等均有有效推进,项目正处于验收阶段。该项目的有效实施将进一步推进公司在先进封装技术领域的技术领先优势与制造服务能力,有力提升公司在高端 MEMS 领域的市场拓展与业务规模。

问题 18:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 19:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 20:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 21:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,并拥有荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进 Anteyon 的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力持续提升,基于 Anteyon 在光学领域领先的研发能力、核心客户群体、市场发展与客户趋势,其业务有望保持快速增长趋势, 感谢您的关注!

问题 22:晶方科技高管,亦荷兰子公司投资者也多年了,作为股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看营收,但亏损,什么时候可扭亏为盈,子公司产品在国产市场是顶级的,我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注, 谢谢!
 答:您好,公司荷兰子公司 Anteyon 具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造